

# 吉林华微电子股份有限公司

## 2011 年年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	华微电子
股票代码	600360
上市交易所	上海证券交易所

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏增文（代）	聂嘉宏
联系地址	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号	吉林省吉林市高新区深圳街 99 号
电话	0432-64684562	0432-64684562
传真	0432-64665812	0432-64665812
电子信箱	hwz99@hwz.com.cn	niejiahong@hwz.com.cn

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,098,115,639.16	1,147,963,851.09	-4.34	1,080,466,375.14

营业利润	68,600,485.04	104,022,405.86	-34.05	11,158,615.35
利润总额	119,753,734.15	98,942,655.35	21.03	35,776,331.50
归属于上市公司股东的净利润	101,742,497.87	82,490,879.67	23.34	26,036,987.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,649,452.93	86,919,452.35	-34.83	-10,240,398.74
经营活动产生的现金流量净额	409,372,419.59	268,229,215.69	52.62	212,795,280.85
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	3,246,784,433.39	3,118,467,336.77	4.11	2,765,514,832.13
负债总额	1,575,352,262.96	1,540,638,227.80	2.25	1,235,806,836.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,654,667,544.48	1,559,762,646.61	6.08	1,507,745,678.47
总股本	678,080,000.00	521,600,000.00	30.00	521,600,000.00

## 3.2 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.15	0.12	25.00	0.04
稀释每股收益 (元 / 股)	0.15	0.12	25.00	0.04
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.08	0.13	-38.46	-0.02
加权平均净资产收益率 (%)	6.32	5.33	增加 0.99 个百分点	1.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.52	5.61	减少 2.09 个百分点	-0.69
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.60	0.51	17.65	0.41
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	2.44	2.99	-18.39	2.89
资产负债率 (%)	48.52	49.40	减少 0.88 个百分点	44.69

## 3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	198,854.16	-2,594,617.46	11,101,874.78
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规	53,262,000.00	211,000.00	28,990,000.00

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-26,846.32	291,982.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,117.06	-1,569,582.79	213,834.85
少数股东权益影响额	55,864.67	-19,800.58	-160,565.65
所得税影响额	-7,827,556.83	-428,725.53	-4,159,739.76
合计	45,093,044.94	-4,428,572.68	36,277,386.50

#### § 4 股东持股情况和控制框图

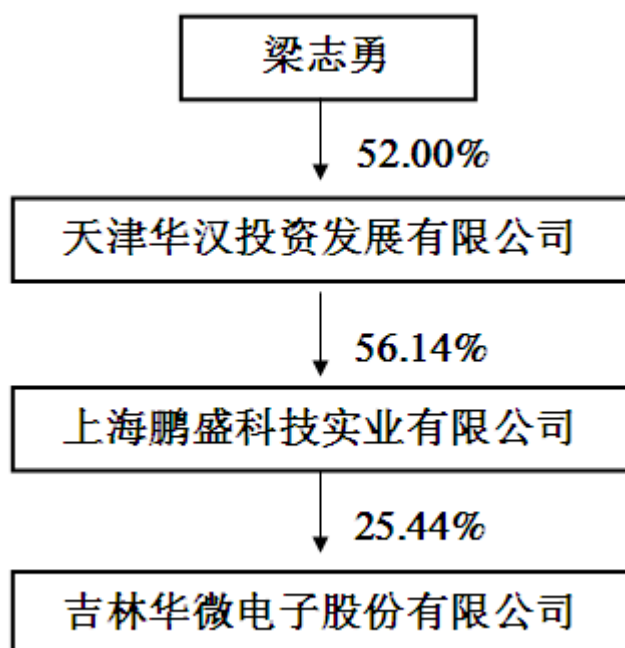
##### 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	85,034 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	84,441 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海鹏盛科技实业有限公司	境内非国有法人	25.44	172,493,513	39,806,195	0	质押：172,023,475
吉林市中小企业信用担保有限公司	国有法人	2.65	17,940,000	4,140,000	0	无
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划	未知	0.50	3,400,000	3,400,000	0	无
邱国富	未知	0.34	2,293,050	2,293,050	0	无
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.29	1,942,468	1,942,468	0	无
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	未知	0.27	1,838,171	1,838,171	0	无
肖贵清	未知	0.27	1,815,840	419,040	0	无
王曼云	其他	0.25	1,700,000	1,700,000	0	无
崔海花	其他	0.25	1,697,890	1,697,890	0	无

沈昌明	未知	0.24	1,635,928	1,635,928	0	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
上海鹏盛科技实业有限公司		172,493,513		人民币普通股		
吉林市中小企业信用担保有限公司		17,940,000		人民币普通股		
东海证券—交行—东风 5 号集合资产管理计划		3,400,000		人民币普通股		
邱国富		2,293,050		人民币普通股		
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,942,468		人民币普通股		
中国工商银行股份有限公司—嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		1,838,171		人民币普通股		
肖贵清		1,815,840		人民币普通股		
王曼云		1,700,000		人民币普通股		
崔海花		1,697,890		人民币普通股		
沈昌明		1,635,928		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名股东中，国有法人股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事会报告

### 5.1 管理层讨论与分析概要

#### 1、报告期内公司总体经营情况回顾

##### (1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，受欧债危机影响国际经济环境不断恶化，国内经济受到通胀压力加剧以及人民币不断升值的影响增速也呈现逐季减缓趋势，这在一定程度上导致中国的半导体行业发展速度低于预期，但中国的半导体行业受到国家发展战略性新兴产业以及鼓励节能减排等政策的扶持，仍具有非常良好的发展空间。华微电子作为中国半导体分立器件行业的领先企业之一，坚定地实施围绕半导体分立器件这一领域做大做强战略，2011 年公司在收缩与行业弱相关业务的同时，进一步深化半导体分立器件业务“市场结构、客户结构、产品结构”，的调整，即通过高端二极管、新型电力电子器件领域新产品的开发、量产带动公司产品结构的升级与优化，同时，通过产品结构的升级与优化拉动公司向更高层次市场、更优质更具战略合作价值的客户方向进行调整。

2011 年，公司的六英寸新型功率半导体器件生产线项目正式投产，标志着公司在产业升级和产品结构优化等方面取得重大进展。目前，公司已形成了一整套较为成熟的 MOS 产品的产品设计、生产制造、生产管理和品质保障体系，具备月产 4 万片的生产能力，并先后推出了四代产品，产品性能达到或接近国外同行的水平，在市场中建立起了良好的口碑，产销规模稳步提高。2011 年是该项目投产后的第一年，达产率和产品合格率经历了一个逐步提升的过程，同时由于受项目建设期内建筑材料价格及人工费上涨等不可控因素的影响，项目的实际投资规模和折旧费用有较明显的增加，加之四季度受欧债危机影响市场又出现了波动，项目在 2011 年度未能如原预想实现盈利。2012 年，公司将抓紧进行设备的进一步磨合和工艺的进一步完善，以进一步提高产品合格率，降低废片率，降低成本，同时抓紧新产品的开发和工艺调试，增加产品型号，提高产品性能，进一步加强市场拓展的深度和广度。随着公司 MOS 技术工艺更趋成熟，产品型号更加丰富，产品性能更加优化，客户认可度进一步提高，产销规模将得到进一步提升，规模效应将得到更充分的发挥，生产成本将得到有效降低，盈利能力也将随之逐步得到发挥。

报告期内，公司实现主营业务收入 108,684.39 万元，比去年同期下降 4.30%；实现净利润 10,174.25 万元，比去年同期增长 23.34%；基本每股收益为 0.15 元。

##### (2) 报告期内公司技术创新与新产品研发情况

在 MOS 产品领域，公司成功开发 0.45um Spacer 工艺，并在此平台上试制了 JCS24N50H、JCS20N60、15N60 三个系列产品，同时公司通过近半年的攻关，开发出 TRENCh 工艺平台，TRENCH 平台的开发建设成功意味着公司可以大幅降低现有产品的外形尺寸，并提供更高的使用效率，对于 MOS 系列产品性能提升、成本降低具有重要作用。在 IGBT 领域，公司已成功研发并批量产出 1200V15A 产品，目前正研制开发 1200V20A、600V40A、360V50A、3300V400A 产品，目前部分产品已进入小批量试流阶段。在肖特基二极管领域，公司已成功开发出 HBR30100、HBR3200、HBR5100、HBR5150、MBR540、MBR560、HBR3150 等 DO 系列产品，NMBRS1245AG、MBRS1245AG、SBL3045AG 等太阳能用系列产品以及 200V 超势垒产品。在快恢复二极管领域，公司已成功开发出 400V-600V 系列 5A/8A/10A/15A/30A/50A/75A/200A 产品及 1200V 系列 8A/30A/75A 产品。上述技术与产品的成功研发将推动公司产品结构及市场、客户结构的进一步优化，为公司后续发展铺垫了良好的技术基础。

##### (3) 下属子公司的主要业绩

公司为专一发展半导体元器件产业，减少多元化经营风险，从 2009 年开始陆续对投资公司进行优化整合，集中资金和技术致力于半导体元器件产业的发展和壮大，以形成研发、

制造和销售的综合产业链结构,充分发挥半导体产业的规模效应。公司本年度出售了业务关联度较小的参股公司厦门永红、上海华微的股权,并为统一管理销售市场、控制研发技术出售了原子公司深圳鹏微的股权,同时完成了 2010 年度开始的广州华微与无锡吉华封装资源整合任务本年度顺利的关闭了原子公司无锡吉华。

截止 2011 年期末,公司主要子公司为吉林麦吉柯和广州华微:吉林麦吉柯主要业务是 5 英寸芯片的生产制造和销售,并拥有自己的研发与技术平台,公司主要产品包括肖特基、快恢复、MOSFET 和 MJE,并为美国仙童公司提供代工业务,2011 年当年实现净利润 2,526 万元,占公司整体净利润的 25%,公司本年度实现主营业务收入 23,424 万元、主营业务利润 5,870 万元,截止报表日公司注册资本 7,000 万元、总资产 38,158 万元、净资产 20,324 万元,吉林麦吉柯公司无论从产品方向还是生产资源继续利用发面都有一定的潜力。

广州华微主要性质是半导体芯片的封装与测试,公司拥有独立的封装技术,日常业务除承接集团公司芯片的封装与测试,同时为其他芯片厂家做代工业务,由于公司成立时间较短,目前正处于产能提升阶段,公司本年度实现净利润 264 万元,截止报表日公司注册资本 4,000 万元、总资产 22,845 万元、净资产 4,382 万元。由于广州华微的地理位置优势,将来不但承载着公司的封装加工业务更为销售市场的信息取得与客户开发提供了便利条件。

## 2、公司未来发展展望

### (1) 公司所处行业的发展趋势,面临的市场竞争格局及公司发展战略

赛迪顾问公司预测:随着中国经济以调结构、促内需为主线,大力发展新兴产业,分立器件作为现代产业发展的基础在各领域得到广泛应用。中国分立器件市场将持续保持较好的增长态势,市场规模将持续扩大,2013 年中国分立器件销售额将突破 1500 亿元,其销量和销售额将始终保持 10%以上的水平。

面对如此良好的行业发展环境,对于公司是难得的发展机遇,公司将集中现有资源加快提升核心竞争力,通过技术提升、产能提升、产品质量提升,快速抢占市场,同时利用自身不断提升的品牌影响力逐步扩展现有存量市场,

### (2) 2012 年经营计划

2012 年全球经济复苏减缓且下行趋势风险加大,尽管美日经济缓慢复苏、新兴经济体保持较快增长但增速放缓,然而欧洲主权债务危机继续深化,在经济全球化深入发展和各国经济依存度加深的条件下,将会严重影响欧洲经济甚至存在拖累全球经济复苏的可能。如此扑朔迷离的宏观经济形势,使得市场趋势和企业经营面临的不确定性和复杂性大大增加,国内半导体行业受经济萧条预期的影响,市场需求萎靡不振、波动异常剧烈,如何在这样急剧动荡和愈趋复杂的宏观形势下维持企业的生存和谋求未来的发展仍然是唯一重要的经营课题!面对如此的市场环境与经营背景,只有树立积极的经营思想,采取主动的经营策略,坚定地融入市场、参与竞争才是唯一的出路!确定以下几方面重点工作内容:

1) 市场营销方面:其一、制定以客户为导向的市场战略,确立客户作为战略性资产的重要地位,为提供更好的对应服务而逐步分类、分级对客户资源进行管理,以客户关系管理的方法和工具,逐步推进内部顾客的市场链管理和外部顾客的关系营销;其二、以解构和建构交融并行的办法,破立并举、逐步推进,区别产品、领域、客户和时间尝试实施组合营销和整合营销,探索一条适合华微厂情的营销管理思路和结构化管理办法,逐步建立包含产品、价格、渠道、促销等营销要素的全新的市场营销管理体系;其三、确立以三大区域老总和三大产品负责人为拳头力量和尖刀队伍,优势互补、结伴成组,锁定和聚焦个别重点大客户,集中优势兵力各个击破,并以此为突破口、重新构建华微电子的客户结构体系,最终扭转当前不利的、结构失衡的市场格局。

2) 运营管理方面:其一、以市场订单为依据加强计划的调控管理功能,以市场保障能力和客户响应速度的提高为目的来改善计划指挥系统对资源进行合理调配的能力与水平,紧

紧围绕“三项结构调整”来确定目标、分解任务、指导运营和监督实施；其二、继续严格推行“周计划管理”的方法和工具，逐步深入转变生产管理模式，整合内部和外部资源，加快响应市场变化的内部生产运营的节奏，提高劳动生产率，走上速度快、效益高的精细化生产道路；其三、依据不同产品线的特殊需求和实际特点，具体问题具体分析，逐步尝试不同的订单管理办法，摸索出一条多种体制并行不悖的运营管理模式；其四、继续坚持“盘活存量、科学合理控制增量”的指导方针，深入推进“去库存化”的工作，加快存货周转，降低库存积压，快速回笼资金，提高现金流入的速度和流量；其五、继续推动以促进企业内部价值链的有效衔接和快速联动为目的的业务流程再造，逐步扩展到构建和完善企业内外兼容、灵活柔韧的供应链和价值网络，缓解市场需求波动剧烈影响下的供需结构矛盾，降低供应过剩或供应不足给企业经营带来的风险。

3) 财务管理方面：继续加强财务管控手段，以全面提升公司资产运营效率为目标，以公司资产保值增值为重心，以上市公司财务管理指标为准绳，建立健全预算决算管理体系，在保障经营稳定的前提下严格控制“三项资金、三项费用”，逐步推动经营工作良性发展。

4) 技术管理方面：其一、全面深入推进材料通用性和工艺兼容性以及前后端技术标准统一整合的柔性生产技术管理要求的落实，从技术角度逐步减少制约生产和销售的诸多瓶颈环节和扩展性约束，促进生产资源和库存资源的快速有效流动；其二、继续坚持以引进、消化、吸收和创新的方式来推进技术管理工作，引导和激发产品和技术研发能力的提升，立足产品结构的优化，全力打造工艺稳定的技术平台。

5) 质量管理方面：以产品质量客户零投诉为目标，继续坚持转变质量管理模式，以提供优于竞争者的产品和服务为目标，快速响应客户需求。加强过程质量控制，明确落实质量责任，增强全员质量意识，降低质量成本损失，积极推进以 TS16949 质量体系为指引的质量管理体系再造。

6) 安全管理方面：其一、细化生产过程以识别危险因素，形成各工序安全工作标准和检查控制点，并突出“技术安全”实现人机联防，定期或不定期全面组织开展安全检查，确保安全生产不出事。其二、规范重点要害部位、重要物资、重点时段、重点人员的管理，做好企业内部治安治理，保障公司资产安全，确保公司资产不流失。其三、进一步落实环境保护法律法规，实现绿色生产无污染。

7) 产品管理方面：其一、继续推行产品结构调整，深入转变产品管理模式，以分产品线进行精细管理的方式，打造产品类别的差别优势，进而实现整体产品的市场全面竞争力；其二、继续全力开拓 VDMOS 产品系列化工作，加强高端产品研发，积极拓展高端产品的应用领域和客户市场，拓宽和延伸公司的产品线，逐步实现产品结构的根本转变，延长整体产品的生命周期，最终使参与市场竞争的企业生命周期得以延展。

8) 基础管理方面：其一、着眼于业绩和成果，以服务市场为宗旨，在对接市场的业务流程管理上推行“精兵简政”，简化和去除繁琐、复杂、无效的管理流程和制度规定，提高跨部门和部门内的办公效率，在控制管理风险的前提下缩减过度或过严的职能审批，提升公司整体工作绩效；其二、继续构建和完善公司绩效管理体系和激励机制，逐步深入推进全员绩效管理，以关键岗位和骨干人才的激励为切入点，研究制定并逐步实施全员激励机制模式；其三、推动以经营为核心、以管理为辅助的企业管理定位模式，强化经营管理之于企业生存发展的主线地位，明确职能管理之于企业生存发展的辅助地位，管理促进经营、管理服从经营，向管理要效益、向经营要成果，最终促进管理水平的提高和经营质量的提升。

9) 管理创新方面：其一、以双极产品事业部的设立为试点，总结前期 BJT 实验项目的经验和教训，大胆尝试生产直接对应销售的运营模式，加强保障市场能力和灵活应对需求变化，逐步过渡到以产品为业务中心、以“地方自治”为管理特色的“战略事业单位(SBU)”式的企业治理结构和经营管理模式，同时推动总部职能部门以服务为主旨、以“抓大放

小”“有所为有所不为”为原则，全面推进事业部制业务管理的平稳运行和组织结构管理的巩固落实；其二、积极推进芯片车间的“工段式”的生产管理方式，取消生产管理、工艺管理和设备管理的原有三类职能分割式管理方式，促进以工段长为基本管理层级、三位一体式的生产运营模式，提高生产车间在内部生产管理上的自主性和灵活性。

(3) 对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的策略和措施：

1) 宏观环境变化难以预测和把握的风险。2011 年中国的经济增速处于逐季减缓的态势，到 2012 年能否进入一个上升通道，仍处于未知，这给企业的经营效果的实现带来了较大的不确定性。

2) 高端人才匮乏的风险。公司在多年发展中积累了一定的人才优势，但与急剧发展的半导体行业需求相比，高层次技术人才和管理人才仍显不足。

面对上述风险因素，华微电子采取了相应措施，努力将风险因素的影响降至最低。

1) 公司加强内部运行质量的提升。目前国际、国内经济环境不甚明朗，但作为中国半导体分立器件行业受国家节能减排、战略性新兴产业系列政策的扶持仍具有良性的发展空间。华微电子作为中国半导体分立器件领域领先企业之一，但所占市场份额仍然较小，因此公司在当前环境下，在关注行业发展动态的同时，公司更致力于加大内部运行质量的提升，坚持以“三项资金、三项费用”优化与控制为主线，通过“周计划管理”将公司运营体系前后紧密衔接，减少资源浪费，同时通过产品结构的升级拉动公司市场结构、客户结构的优化进而提升公司的市场份额，减少宏观环境对公司的影响。

2) 随着中国半导体企业的发展，对于高端人才的需求也不断增加。但面对目前高流动性的人力资源市场，如何建立一支高素质、稳定的高端人才团队成为企业一个必须面对的问题。为此，公司始终将人力资源的开发与人力资本的培育视为一项战略性任务，通过内部人力资源整体平台的搭建，构建一个能够吸引更多高素质人才的人力资源体系及内部环境，同时加大对内部现有人员的培养，通过公开培训、外派学习等手段提升现有人员的能力与素质，逐步建立一支充满生机与活力的人才队伍。

报告期内公司资产构成同比发生重大变动说明：

项 目	期末数	期初数	变化比率
应收票据	188,223,878.98	138,340,346.45	36.06%
预付款项	43,501,501.19	89,263,921.24	-51.27%
在建工程	97,110,452.32	74,200,073.49	30.88%
无形资产	190,843,704.77	142,269,718.00	34.14%
应付票据	262,055,251.57	151,032,554.71	73.51%
预收款项	1,633,954.39	3,116,922.25	-47.58%
应付利息	12,931,982.96	6,781,329.86	90.70%
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	5,000,000.00	2900.00%
长期借款	4,600,000.00	156,193,916.53	-97.05%
股本	678,080,000.00	521,600,000.00	30.00%

注：

(1) 应收票据期末数比期初数增加 49,883,532.53 元，增加比例为 36.06%，增加原因为公司销售业务中回款以票据结算的比例增加所致。

(2) 预付款项期末数比期初数减少 45,762,420.05 元，减少比例为 51.27%，减少原因

为预付款业务中的工程项目完工决算、采购设备业务到货验收入库所致。

(3) 在建工程期末数比期初数增加 22,910,378.83 元, 增加比例为 30.88%, 增加原因为公司投资电力电子器件基地项目所致。

(4) 无形资产期末数比期初数增加 48,573,986.77 元, 增加比例为 34.14%, 增加原因为公司购买土地、专利和非专利技术所致。

(5) 应付票据期末数比期初数增加 111,022,696.86 元, 增加比例为 73.51%, 增加原因为公司加强资金管理, 付款业务中以银行承兑汇票支付的比例增加所致。

(6) 预收款项期末数比期初数减少 1,482,967.86 元, 减少比例为 47.58%, 减少原因为公司销售业务中预收款项有所减少所致。

(7) 应付利息期末数比期初数增加 6,150,653.10 元, 增加比例为 90.70%, 增加原因为银行基准贷款利率上调、第二期短期融资券利率上调并按照合同约定本年计提年底未付利息期数多于上年度所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加 145,000,000.00 元, 增加比例为 2900%, 增加原因为公司期末长期借款一年内到期的金额重分类到此项目所致。

(9) 长期借款期末数比期初数减少 151,593,916.53 元, 减少比例为 97.05%, 减少原因为公司期末长期借款一年内到期的金额分类至一年内到期的非流动负债所致。

(10) 股本期末数比期初数增加 156,480,000.00 元, 增加比例为 30.00%, 增加原因为公司资本公积转增股本、送红股所致。

报告期内公司主要财务数据发生重大变化说明:

项目	本期数	上期数	变动比率
营业税金及附加	8,643,946.72	6,408,804.42	34.88%
资产减值损失	8,840,520.27	17,162,234.18	-48.49%
投资收益	6,347,024.51	4,202,009.96	51.05%
营业利润	68,600,485.04	104,022,405.86	-34.05%
营业外收入	54,380,941.06	1,440,071.97	3676.27%
营业外支出	3,227,691.95	6,519,822.48	-50.49%

注:

(1) 营业税金及附加本期数较上年同期数增加 2,235,142.30 元, 增加比例为 34.88%, 增加原因为报告年度教育费附加计提比率按规定上调 2%、出口销售收入增加导致其承担的城建教附金额亦增加所致。

(2) 资产减值损失本期数较上年同期数减少 8,321,713.91 元, 减少比例为 48.49%, 减少原因为公司加强存货和应收账款管理, 本期计提的存货跌价准备和坏账准备减少所致。

(3) 投资收益本期数较上年同期数增加 2,145,014.55 元, 增加比例为 51.05%, 增加原因为本年度转让公司持有厦门永红、上海华微股权和关闭无锡吉华确认收益所致。

(4) 营业利润本期数较上年同期数减少 35,421,920.82 元, 减少比例为 34.05%, 减少原因为本年度受宏观经济影响, 公司产能利用率、降低成本增加、毛利率降低所致。

(5) 营业外收入本期数较上年同期数增加 52,940,869.09 元, 增加比例为 3676.27%, 增加原因为公司本期收到与收益有关的政府补助确认收入所致。

(6) 营业外支出本期数较上年同期数减少 3,292,130.53 元, 减少比例为 50.49%, 减少原因为本期处理固定资产损失和本期捐款少于上年同期所致。

报告期内公司现金流量构成同比发生重大变动说明:

项目	本期数	上期数	变动比率
----	-----	-----	------

经营活动产生的现金流量净额	409,372,419.59	268,229,215.69	52.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-103,196,351.31	73,875,905.11	

注：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 141,143,203.90 元,增加比例为 52.62%,增加原因为公司加强应收账款清收回款增加、期末支付超过三个月的银行票据保证金减少所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 177,072,256.42 元,减少原因为本年度公司调整负债结构,归还银行贷款所致。

## 5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	1,059,215,019.15	754,203,637.22	28.8	-4.09	-2.22	减少 1.36 个百分点
商业	16,715,228.12	16,715,231.48	0	-20.10	-14.56	减少 6.48 个百分点
服务业	10,913,626.40	2,148,952.32	80.31	4.57	-0.51	增加 1.01 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
(1) 半导体器件	1,059,066,045.63	753,306,992.58	28.87	-4.10	-2.33	减少 1.29 个百分点
(2)其他	27,777,828.04	19,760,828.44	28.86	-11.41	-9.04	减少 1.86 个百分点

## § 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

本年 11 月注销无锡吉华电子有限责任公司,故本年底不再将其纳入合并报表范围。

本年 9 月底出售所持有的深圳市鹏微科技有限公司 70% 的股权,故自 10 月起不再将深圳市鹏微科技有限公司纳入合并报表范围。